

**Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações**  
**Secretaria de Políticas de Infomática (SEPIN)**

**ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO DE PLEITO PARA  
RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE COMPONENTE INTEGRADO  
SEMICONDUTOR DESENVOLVIDO NO PAÍS**

**Portaria MCTI nº 1.309/2013**

**DADOS DA EMPRESA**

- *Fornecer as informações em conformidade com os itens especificados, respeitando sua ordem e sem lacunas. Nos itens não aplicáveis à situação da empresa indicar essa condição no próprio item, justificando-a.*

## **1. CARACTERIZAÇÃO**

### **1.1. Atividades em SEMICONDUTORES**

Descrever as principais atividades exercidas pela empresa nas áreas de Semicondutores:

### **1.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

Informar, por unidade ou estabelecimento fabril, as atividades exercidas pela empresa nas áreas de Semicondutores e eventuais outras atividades produtivas:

1.2.1. Unidade ou Estabelecimento (se for mais de um, para distingui-los, acrescentar à numeração do subitem letras como, 1.2.1.1.a, 1.2.1.1.b etc).

1.2.1.1. Nome / Razão Social:

1.2.1.2. CNPJ:

1.2.1.3. Endereço:

1.2.1.4. Telefone:

1.2.1.5. Pagina na Internet (se houver):

1.2.1.7. Atividade(s) desenvolvida(s) na empresa:

1.2.1.6. Nome, cargo, endereço, telefone e correio eletrônico (e-mail) do representante legal da empresa e do responsável pelas informações prestadas no requerimento;

1.2.1.8. Outras atividades de produção de bens e serviços:

1.2.1.9. Outras informações que se julguem necessárias à identificação da empresa;

---

## INFRAESTRUTURA DE P&D

### **2. GESTÃO TECNOLÓGICA EM PROJETO DE SEMICONDUTORES**

#### **2.1. ORGANOGRAMA DA ÁREA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D) DA EMPRESA.**

Apresentar o organograma com a indicação do número de profissionais internos (I) - funcionários da própria empresa - e externos (E), englobando-os por cargo ou função, lotados em cada uma de suas unidades:

#### **2.2. QUADRO DE PESSOAL DE P&D**

2.2.1. Funcionários da empresa próprios – total de nível médio e superior:

2.2.2. Funcionários da empresa terceirizados – total de nível médio e superior:

2.2.3. Outros profissionais envolvidos nas atividades de P&D em semicondutores.

2.2.4. Relação completa dos integrantes da equipe técnica que concebeu, especificou e executou o projeto de desenvolvimento, informando nome, domicílio, formação, e-mail de contato, experiência profissional, atividades desenvolvidas no projeto e vínculo com a empresa.

#### **2.3. PATENTES E REGISTROS**

2.3.1. Relacionar as principais patentes em semicondutores requeridos ou obtidos, indicando o objeto, a data do pedido ou da concessão, o órgão requerido ou concedente e seu respectivo país.

2.3.2. Receitas decorrentes da cessão de direito de uso de patentes em propriedade intelectual de propriedade da empresa.

Valores em R\$

<b>RECEITAS (PATENTES/ PROPRIEDADE INTELECTUAL)</b>			
<b>PERÍODO ANO</b>	<b>PATENTE</b>	<b>ESPICIFICAÇÃO</b>	<b>TOTAL</b>
⋮	⋮	⋮	⋮

2.3.3. Pagamentos ou remessas efetuadas pela empresa em decorrência da utilização de patentes ou propriedade intelectual de terceiros para o desenvolvimento do componente:

Valores em R\$

<b>PAGAMENTOS/REMESSA PARA PROPRIEDADE INTELECTUAL DE TERCEIROS EM SEMICODUTORES</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>PAÍS</b>
⋮	⋮	⋮	⋮

2.3.4. Pagamentos ou remessas efetuadas pela utilização de ferramentas de projeto de terceiros, bem como as demais remessas e demais pagamentos destinados ao desenvolvimento do componente:

Valores em R\$

<b>PAGAMENTO/REMESSAS DE TI</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>PAÍS</b>
⋮	⋮	⋮	⋮

*No caso de componente eletrônico semicondutor complementar desenvolvido por terceiros ou blocos funcionais proprietários (IP), bem como programas de computador residentes ou embarcados ("firmware") que tenha ou não tenha sido desenvolvido no País, o interessado deverá apresentar o respectivo contrato de transferência ou licenciamento de uso, firmado com a respectiva instituição ou empresa que os desenvolveu;*

## ESPECIFICAÇÃO DO COMPONENTE

### **3. CONCEPÇÃO E DETALHAMENTO DE DESENVOLVIMENTO.**

#### 3.1. DEFINIÇÃO DA CONCEPÇÃO BÁSICA DO COMPONENTE

Informar e anexar se necessário os documentos de especificação que contemplem as informações pedidas abaixo:

- 3.1.1. Detalhamento da aplicação do componente (uso):
- 3.1.2. Especificação das funcionalidades do componente:
- 3.1.3. Informação de uso (“*application notes*”):
- 3.1.4. Outras informações que auxiliem na definição e especificação do componente.

#### 3.2. DETALHAMENTO DE ARQUITETURA

- 3.2.1. Apresentação da arquitetura proposta do componente com os respectivos blocos funcionais, interconexões entre blocos e outros que se façam necessários, além do detalhamento funcional de cada um destes (se necessário anexar documentos);

#### 3.3. ESPECIFICAÇÃO FÍSICA E ELÉTRICA

- 3.3.1. Informação detalhada do projeto com especificações físicas e elétricas,

#### 3.4. DOCUMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO

- 3.4.1. Fluxo de projeto utilizado, incluindo a documentação gerada como esquemáticos; códigos em linguagem de descrição de *hardware*; leiaute parcial e de topo, entre outras, necessárias à caracterização do projeto;

#### 3.5. PROCESSO DE FABRICAÇÃO

- 3.5.1. Definição do processo de fabricação e justificativa de escolha,

#### 3.6. TESTES

- 3.6.1. Testes e validações usadas no desenvolvimento, desde o mais alto nível de abstração até sistemas “*in-circuit*”.

#### 3.7. ENCAPSULAMENTO

- 3.7.1. Tipos e especificação dos modelos de encapsulamento definidos no projeto a serem comercializados;

#### 3.8. ESPECIFICAÇÃO DE TECNOLOGIA E FERRAMENTAS UTILIZADAS

- 3.8.1. Detalhamento das tecnologias de propriedade intelectual e programas de computador utilizados no desenvolvimento das geometrias do leiaute do componente e em outras fases do projeto;
-

### 3.9. DISPOSITIVOS PROGRAMÁVEIS

3.9.1. No caso de dispositivos lógicos programáveis, tais como circuitos integrados FPGA ou PLD complexos com mais de 2.000 portas, apresentar documentação que comprove o desenvolvimento do software de programação destes dispositivos e os referidos testes de validação do componente;

3.9.2. Apresentação de marca e modelo de dispositivo programável utilizado, a justificativa de uso e detalhes sobre a tecnologia utilizada.

- *No caso de dispositivos lógicos programáveis, todas as informações pertinentes que se enquadram em outros tópicos devem ser fornecidas nos referidos tópicos;*

### 3.10. PROTOTIPAGEM

3.10.1. Informações e documentações relacionadas à prototipagem do componente, que se façam necessárias à comprovação do desenvolvimento;

### 3.11. GERAL

3.11.1. Outras informações que se façam necessários a este item;

## 4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

---